

# 間仕切りによる空調負荷の軽減

この電子部品製造工場の金型製造工程では品質管理のため、温湿度管理が必要です。

そのためフロア全体を23℃で温度管理していました。

金型以外の工程は温湿度条件を緩和しても問題ないことが分かり、金型工程を仕切り、全体の空調負荷の軽減を図りました。

## 【改善内容】

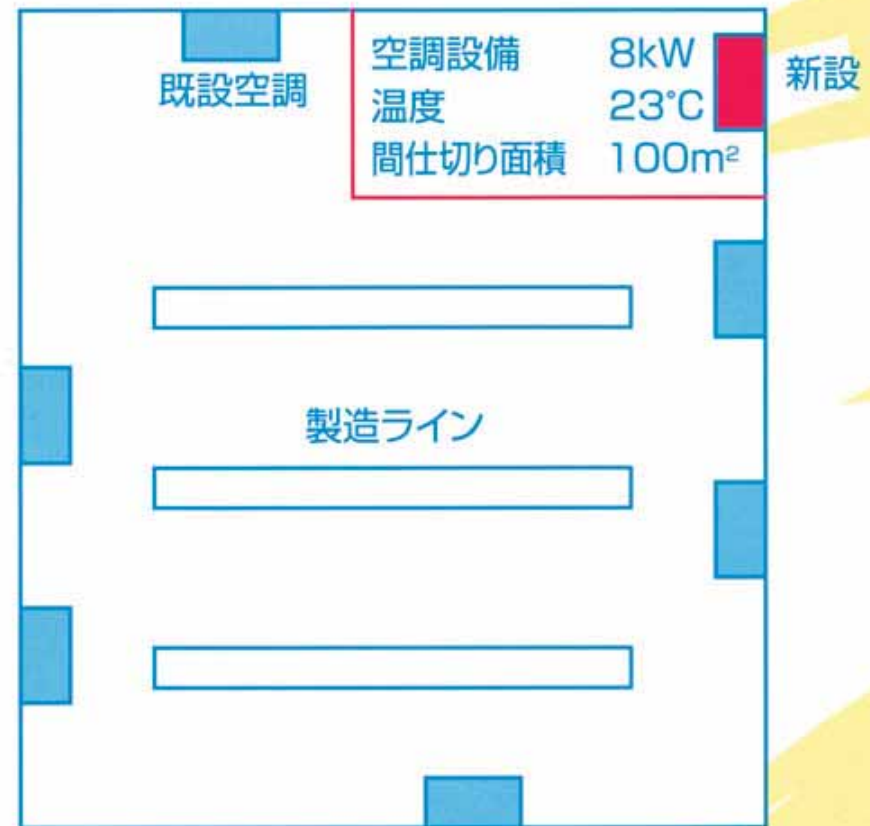
- 金型工程エリア100m<sup>2</sup>を間仕切りし、新たに空調設備8kWを設置し、温湿度環境の向上を図った。
- 他のエリアは空調設定温度を23℃から28℃に緩和して、空調負荷の軽減を図った。

## 【改善効果】

- 削減電力量:52,800kWh/年

改善費用	改善効果	回収年数
300万円	53万円/年	5.7年

## ■システム図



全般空調面積 1,200m<sup>2</sup>→1,100m<sup>2</sup>  
温度 23℃→28℃  
空調設備 60kW